OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

LOCTITE ECCOBOND E 1172 A

IDH1189513
LOCTITE ECCOBOND E 1172A, 15G

- Yksikomponenttinen
- Nopea kovettuminen alhaisissa lämpötiloissa
- Alhainen CTE
- Pitkä käyttöaika



TUOTEKUVAUS

LOCTITE® ECCOBOND E 1172 A on void-vapaa, epoksipohjainen underfill-kapselointimateriaali, joka on suunniteltu käytettäväksi erittäin hienojakoisilla area array -komponenteilla, joissa SMT-prosessin läpinäkyvyys on kriittistä. Sitä voidaan käyttää flip chip -komponenteilla jopa 25 mikrometrin geometrioihin saakka. Levitettynä se muodostaa tasaisen kapseloinnin, jolla on voimakas tartuntalujuus, ja maksimoi komponentin lämpösyklien keston jakamalla rasitusta pois juotosliitoksista.

SULATUS:

1. Kun ruiskut on otettu pakastimesta, aseta ne pystyasentoon sulamisen ajaksi.
2. Ruiskujen tulee sulaa vähintään 60 minuuttia.

KÄYTTÖOHJEET

1. Esilämmitä kokoonpano 90–120 °C:een. Korkeammat lämpötilat lyhentävät underfillin valumisaikaa.
2. Annostele underfill-materiaalia ruiskulla, jossa on 23 gauge -neula (tai suurempi), joko yhdelle sivulle (suora linja) tai kahdelle sivulle (L-muoto) komponentin reunaa pitkin.
3. Pidä lämpötilassa, jotta kapillaarinen virtaus pääsee tapahtumaan.
4. Erittäin suuret komponentit saattavat vaatia useamman annostelun, mutta useimmissa tapauksissa toista annostelua eli niin sanottua “fillet pass” -vaihetta ei tarvita.

TEKNISET TIEDOT

Kovetusmenetelmä	Korotettu lämpötila
Kovuus	90 ShD
Sekoitussuhde	Yksikomponenttinen
Sovellus	Underfill, Flip Chip
Säilyvyys	6 kuukausi
Varastointi	-20...-40C
Viskositeetti	17000cP
Väri	Beige